

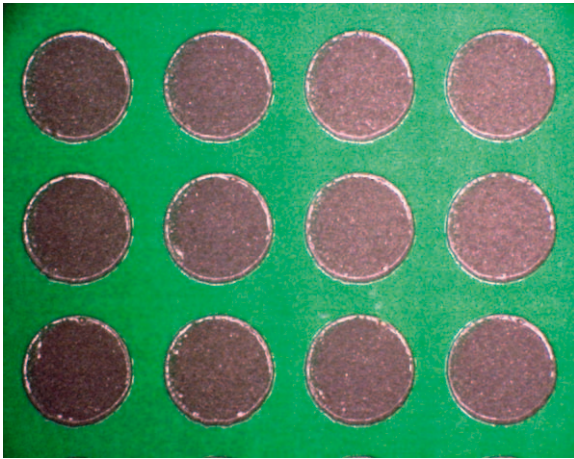
鉛フリー対応 Lead Free

アウトープリコート用 ソルダペースト

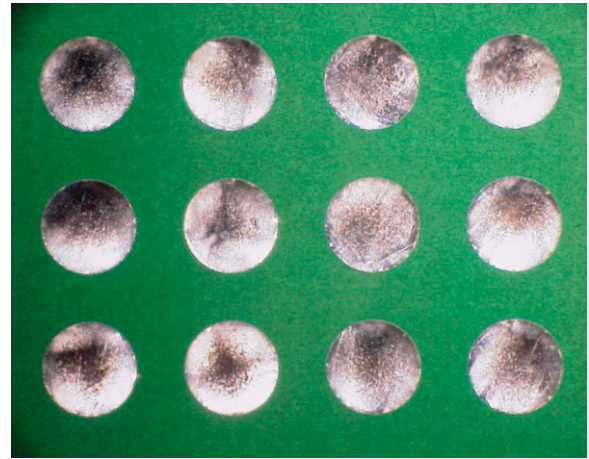
Solder Paste for Outer-pad Pre-coat

LFSOLDER LF-204-91

理想的な被膜を安定して実現
We realize it with the ideal film safe.



印刷後
after printing



リフロー後
after reflow

特長

- 水溶性プリフラックス被膜へのはんだプリコート用に最適です。
- 連続印刷時の経時変化が少なく、安定した印刷性が得られます。
- フラックス残さは、準水系洗浄剤により洗浄可能です。

FEATURES

- Suitable for outer-pad pre-coat on OSP film
- More stable printability with a less change when printing continuously.
- Possible to clean flux residues by quasi water-soluble detergents.

項目	ITEM	LF-204-91
はんだ合金組成	Solder Alloy Composition	Sn/3.0Ag/0.5Cu
融点	Melting Point (°C)	216~220
はんだ粉末の粒度分布	Particle Size of Solder Powder (μm)	1~12
フラックス含有量	Flux Content (%)	26.0
塩素含有量	Chlorine Content (%)	0.0
粘度	Viscosity (Pa-s)	80